

電子回路基板生産動向(2018年)

	当月実績		前年同月比		累 計		前年同期間比		
	数量 (千㎡)	生産額 (百万)	数量 (%)	生産額 (%)	数量 (千㎡)	生産額 (百万)	数量 (%)	生産額 (%)	
平成30年1月実績	電子回路基板	1,147	37,435	96.3	102.5	1,147	37,435	96.3	102.5
	リジットプリント配線板	811	24,086	99.2	101.5	811	24,086	99.2	101.5
	片面プリント配線板	134	702	102.4	99.2	134	702	102.4	99.2
	両面プリント配線板	361	5,651	100.1	106.0	361	5,651	100.1	106.0
	多層プリント配線板(4層)	167	4,262	97.1	102.3	167	4,262	97.1	102.3
	多層プリント配線板(6~8層)	68	4,882	91.3	97.6	68	4,882	91.3	97.6
	多層プリント配線板(10層以上)	10	1,552	104.5	99.9	10	1,552	104.5	99.9
	ビルトアップ多層配線板	71	7,037	100.9	100.9	71	7,037	100.9	100.9
	フレキシブルプリント配線板	273	4,627	86.4	96.9	273	4,627	86.4	96.9
	片面フレキシブル配線板	81	943	96.8	105.4	81	943	96.8	105.4
	両面・多層フレキシブル配線板	192	3,684	82.6	95.0	192	3,684	82.6	95.0
	モジュール基板	62	8,722	109.0	108.7	62	8,722	109.0	108.7
リジット系モジュール基板	39	8,284	102.9	110.0	39	8,284	102.9	110.0	
その他のモジュール基板	23	438	121.6	88.5	23	438	121.6	88.5	
平成30年2月実績	電子回路基板	1,181	38,895	98.8	105.4	2,328	76,330	97.5	103.9
	リジットプリント配線板	839	24,890	99.7	102.5	1,650	48,976	99.4	102.0
	片面プリント配線板	150	760	113.4	105.7	284	1,462	107.9	102.5
	両面プリント配線板	364	5,710	96.2	103.7	725	11,361	98.1	104.8
	多層プリント配線板(4層)	175	4,511	100.0	105.3	342	8,773	98.6	103.9
	多層プリント配線板(6~8層)	70	4,931	93.4	96.6	138	9,813	92.4	97.1
	多層プリント配線板(10層以上)	9	1,660	90.2	103.0	18	3,212	97.1	101.5
	ビルトアップ多層配線板	71	7,318	99.4	103.6	142	14,355	100.1	102.3
	フレキシブルプリント配線板	278	4,666	93.6	95.6	551	9,293	89.9	96.3
	片面フレキシブル配線板	88	1,072	100.7	100.5	170	2,015	98.8	102.7
	両面・多層フレキシブル配線板	190	3,594	90.6	94.3	382	7,278	86.4	94.6
	モジュール基板	64	9,339	114.3	120.7	126	18,061	111.6	114.6
リジット系モジュール基板	40	8,879	111.3	123.0	80	17,163	107.0	116.4	
その他のモジュール基板	24	460	119.8	88.5	46	898	120.7	88.5	
平成30年3月実績	電子回路基板	1,246	41,420	99.7	103.0	3,574	117,750	98.3	103.6
	リジットプリント配線板	875	27,389	100.2	102.3	2,525	76,365	99.7	102.1
	片面プリント配線板	136	785	94.5	103.3	420	2,247	103.2	102.7
	両面プリント配線板	384	6,252	99.4	106.6	1,109	17,613	98.6	105.5
	多層プリント配線板(4層)	191	4,850	109.8	105.5	533	13,623	102.4	104.4
	多層プリント配線板(6~8層)	76	5,592	96.4	100.7	215	15,405	93.8	98.4
	多層プリント配線板(10層以上)	9	1,613	94.8	92.5	27	4,825	96.3	98.3
	ビルトアップ多層配線板	79	8,297	97.6	100.5	221	22,652	99.2	101.6
	フレキシブルプリント配線板	293	4,301	93.5	95.1	844	13,594	91.1	95.9
	片面フレキシブル配線板	88	1,202	100.8	105.4	258	3,217	99.5	103.7
	両面・多層フレキシブル配線板	204	3,099	90.7	91.7	586	10,377	87.9	93.7
	モジュール基板	78	9,730	124.5	109.3	204	27,791	116.2	112.7
リジット系モジュール基板	42	9,106	103.9	109.7	122	26,269	105.9	114.0	
その他のモジュール基板	36	624	161.4	104.0	83	1,522	135.8	94.2	
平成30年4月実績	電子回路基板	1,209	38,897	99.3	102.0	4,782	156,647	98.6	103.2
	リジットプリント配線板	873	26,451	104.5	105.3	3,398	102,816	100.9	102.9
	片面プリント配線板	141	740	100.0	98.4	561	2,987	102.4	101.6
	両面プリント配線板	381	6,167	105.6	112.5	1,490	23,780	100.3	107.2
	多層プリント配線板(4層)	186	4,718	105.8	112.7	719	18,341	103.2	106.4
	多層プリント配線板(6~8層)	77	5,177	111.2	107.7	291	20,582	97.8	100.5
	多層プリント配線板(10層以上)	10	1,993	107.5	113.6	38	6,818	99.1	102.3
	ビルトアップ多層配線板	79	7,656	98.7	94.1	300	30,308	99.1	99.6
	フレキシブルプリント配線板	270	4,123	84.5	87.7	1,114	17,717	89.4	93.9
	片面フレキシブル配線板	83	957	86.4	85.2	341	4,174	95.9	98.8
	両面・多層フレキシブル配線板	187	3,166	83.7	88.5	773	13,543	86.8	92.4
	モジュール基板	65	8,323	105.5	100.2	270	36,114	113.4	109.5
リジット系モジュール基板	36	7,808	93.1	100.9	158	34,077	102.7	110.7	
その他のモジュール基板	29	515	126.3	90.5	112	2,037	133.2	93.3	

平成30年5月実績	電子回路基板	1,192	38,239	103.8	105.5	5,974	194,886	99.6	103.7
	リジットプリント配線板	846	25,496	106.8	109.2	4,244	128,312	102.0	104.1
	片面プリント配線板	139	738	95.8	104.8	700	3,725	101.0	102.3
	両面プリント配線板	368	6,159	108.5	115.0	1,858	29,939	101.8	108.7
	多層プリント配線板(4層)	180	4,709	115.4	118.3	898	23,050	105.4	108.7
	多層プリント配線板(6~8層)	75	5,027	112.9	107.9	367	25,609	100.6	101.9
	多層プリント配線板(10層以上)	11	1,870	109.1	114.7	49	8,688	101.2	104.7
	ビルトアップ多層配線板	72	6,993	96.8	99.8	372	37,301	98.6	99.6
	フレキシブルプリント配線板	278	3,735	97.8	92.4	1,392	21,452	91.0	93.6
	片面フレキシブル配線板	76	923	83.4	98.0	417	5,097	93.4	98.6
	両面・多層フレキシブル配線板	202	2,812	104.6	90.7	975	16,355	90.0	92.1
	モジュール基板	68	9,008	94.9	101.5	338	45,122	109.1	107.8
リジット系モジュール基板	40	8,453	99.4	103.0	198	42,530	102.0	109.1	
その他のモジュール基板	28	555	88.9	83.3	140	2,592	121.2	90.9	
平成30年6月実績	電子回路基板	1,232	41,276	96.4	106.2	7,206	236,162	99.0	104.1
	リジットプリント配線板	889	27,499	99.5	104.4	5,133	155,811	101.6	104.1
	片面プリント配線板	140	768	88.5	96.4	840	4,493	98.7	101.2
	両面プリント配線板	391	6,648	98.2	109.2	2,249	36,587	101.2	108.8
	多層プリント配線板(4層)	188	4,885	109.4	109.6	1,086	27,935	106.1	108.8
	多層プリント配線板(6~8層)	80	5,542	105.1	104.9	447	31,151	101.4	102.4
	多層プリント配線板(10層以上)	12	2,187	123.5	125.4	60	10,875	104.9	108.3
	ビルトアップ多層配線板	79	7,469	97.6	93.6	451	44,770	98.5	98.6
	フレキシブルプリント配線板	265	3,934	84.7	82.8	1,657	25,386	89.9	91.8
	片面フレキシブル配線板	82	820	88.2	83.8	500	5,917	92.5	96.3
	両面・多層フレキシブル配線板	182	3,114	83.2	82.6	1,157	19,469	88.8	90.5
	モジュール基板	78	9,843	110.1	126.9	416	54,965	109.3	110.8
リジット系モジュール基板	44	9,181	113.6	129.1	243	51,711	103.9	112.1	
その他のモジュール基板	34	662	105.9	103.0	174	3,254	117.8	93.2	
平成30年7月実績	電子回路基板	1,260	41,469	102.2	105.8	8,467	277,631	99.5	104.4
	リジットプリント配線板	900	27,985	104.1	107.4	6,033	183,796	101.9	104.7
	片面プリント配線板	140	700	97.8	94.7	980	5,193	98.6	100.3
	両面プリント配線板	395	6,904	100.3	115.0	2,644	43,491	101.1	109.9
	多層プリント配線板(4層)	194	4,861	111.5	106.4	1,280	32,796	106.9	108.5
	多層プリント配線板(6~8層)	80	5,491	115.1	106.7	527	36,642	103.2	103.0
	多層プリント配線板(10層以上)	10	1,894	110.1	108.0	71	12,769	105.6	108.3
	ビルトアップ多層配線板	81	8,135	107.3	103.8	532	52,905	99.7	99.3
	フレキシブルプリント配線板	283	4,502	97.2	102.4	1,940	29,888	90.9	93.2
	片面フレキシブル配線板	82	804	105.6	79.7	582	6,721	94.1	93.9
	両面・多層フレキシブル配線板	201	3,698	94.2	109.1	1,358	23,167	89.6	93.0
	モジュール基板	77	8,982	99.5	102.5	493	63,947	107.7	109.6
リジット系モジュール基板	42	8,339	96.6	103.0	284	60,050	102.8	110.8	
その他のモジュール基板	35	643	103.3	97.4	209	3,897	115.1	93.8	
平成30年8月実績	電子回路基板	1,146	38,563	99.9	97.8	9,612	316,194	99.5	103.5
	リジットプリント配線板	824	25,845	103.7	106.2	6,857	209,641	102.2	104.8
	片面プリント配線板	137	775	102.6	104.6	1,117	5,968	99.0	100.8
	両面プリント配線板	364	6,660	104.0	118.3	3,007	50,151	101.4	110.9
	多層プリント配線板(4層)	175	4,642	108.2	112.0	1,455	37,438	107.1	108.9
	多層プリント配線板(6~8層)	73	5,227	109.2	110.6	600	41,869	103.9	103.9
	多層プリント配線板(10層以上)	9	1,760	108.1	111.6	80	14,529	105.9	108.7
	ビルトアップ多層配線板	66	6,781	89.6	90.1	598	59,686	98.5	98.2
	フレキシブルプリント配線板	245	3,965	90.8	84.6	2,185	33,853	90.9	92.1
	片面フレキシブル配線板	68	663	90.6	80.8	650	7,384	93.7	92.6
	両面・多層フレキシブル配線板	177	3,302	90.8	85.4	1,535	26,469	89.7	92.0
	モジュール基板	77	8,753	93.4	84.2	570	72,700	105.5	105.7
リジット系モジュール基板	41	8,100	84.8	83.0	325	68,150	100.1	106.5	
その他のモジュール基板	36	653	105.4	103.7	245	4,550	113.6	95.1	

平成30年9月実績	電子回路基板	1,190	39,570	96.0	97.8	10,803	355,764	99.1	102.8
	リジットプリント配線板	869	27,137	100.7	105.3	7,725	236,778	102.0	104.9
	片面プリント配線板	145	787	94.5	104.1	1,262	6,755	98.5	101.2
	両面プリント配線板	381	6,898	98.5	110.5	3,388	57,049	101.1	110.9
	多層プリント配線板(4層)	184	4,788	110.7	110.3	1,639	42,226	107.5	109.0
	多層プリント配線板(6~8層)	74	5,268	100.9	102.0	675	47,137	103.6	103.7
	多層プリント配線板(10層以上)	9	1,853	102.7	110.7	89	16,382	105.5	108.9
	ビルトアップ多層配線板	75	7,543	101.7	99.4	673	67,229	98.8	98.3
	フレキシブルプリント配線板	245	3,436	82.7	68.3	2,430	37,289	90.0	89.2
	片面フレキシブル配線板	70	671	91.0	84.4	720	8,055	93.4	91.8
	両面・多層フレキシブル配線板	176	2,765	79.8	65.3	1,710	29,234	88.6	88.6
	モジュール基板	76	8,997	95.5	93.1	647	81,697	104.2	104.2
	リジット系モジュール基板	41	8,316	94.6	92.5	366	76,466	99.5	104.8
その他のモジュール基板	35	681	96.5	100.0	281	5,231	111.1	95.7	
平成30年10月実績	電子回路基板	1,263	41,398	97.8	99.5	12,066	397,162	99.0	102.5
	リジットプリント配線板	932	28,053	105.1	110.5	8,657	264,831	102.3	105.5
	片面プリント配線板	164	838	101.0	103.2	1,426	7,593	98.8	101.4
	両面プリント配線板	419	7,350	107.2	121.0	3,808	64,399	101.7	112.0
	多層プリント配線板(4層)	186	4,922	109.4	116.1	1,825	47,148	107.7	109.7
	多層プリント配線板(6~8層)	79	5,599	103.5	107.3	754	52,736	103.6	104.1
	多層プリント配線板(10層以上)	11	1,934	101.1	113.2	99	18,316	105.0	109.3
	ビルトアップ多層配線板	73	7,410	96.1	101.0	745	74,639	98.5	98.6
	フレキシブルプリント配線板	253	4,274	78.0	70.9	2,683	41,563	88.7	86.9
	片面フレキシブル配線板	78	829	85.3	94.3	798	8,884	92.6	92.1
	両面・多層フレキシブル配線板	175	3,445	75.2	66.9	1,885	32,679	87.2	85.6
	モジュール基板	78	9,071	97.0	88.9	725	90,768	103.4	102.4
	リジット系モジュール基板	40	8,395	89.3	87.7	406	84,861	98.4	102.8
その他のモジュール基板	38	676	106.7	106.8	319	5,907	110.5	96.9	
平成30年11月実績	電子回路基板	1,256	40,598	100.7	101.2	13,321	437,760	99.2	102.4
	リジットプリント配線板	922	28,070	105.2	109.9	9,580	292,901	102.6	105.9
	片面プリント配線板	160	838	100.4	104.6	1,587	8,431	98.9	101.7
	両面プリント配線板	406	7,247	107.1	120.6	4,214	71,646	102.2	112.8
	多層プリント配線板(4層)	191	4,555	107.6	104.4	2,016	51,703	107.7	109.2
	多層プリント配線板(6~8層)	84	5,781	112.0	110.2	837	58,517	104.4	104.6
	多層プリント配線板(10層以上)	10	2,077	98.4	129.2	109	20,393	104.4	111.1
	ビルトアップ多層配線板	71	7,572	94.5	100.7	817	82,211	98.2	98.8
	フレキシブルプリント配線板	260	4,637	87.0	81.5	2,943	46,200	88.5	86.4
	片面フレキシブル配線板	71	869	76.4	84.4	870	9,753	91.0	91.3
	両面・多層フレキシブル配線板	188	3,768	91.8	80.9	2,073	36,447	87.5	85.1
	モジュール基板	74	7,891	103.0	88.9	798	98,659	103.3	101.2
	リジット系モジュール基板	35	7,142	82.5	85.8	441	92,003	96.9	101.3
その他のモジュール基板	38	749	134.4	134.7	357	6,656	112.7	100.0	

(出所：経済産業省「機械統計月報」)

(2019/1/18 発表 / 2019/1/18 JPCA作成)

電子回路実装基板生産動向(2018年)

		当月実績		前年同月比		累 計		前年同期間比	
		部品搭載点数 (千個)	生産額 (百万)	部品搭載点数 (%)	生産額 (%)	部品搭載点数 (千個)	生産額 (百万)	部品搭載点数 (%)	生産額 (%)
1月	電子回路実装基板	517,308	11,090	102.3	107.5	517,308	11,090	102.3	107.5
	プリント配線実装基板	480,159	8,511	96.7	100.8	480,159	8,511	96.7	100.8
	モジュール実装基板	37,149	2,579	394.7	137.5	37,149	2,579	394.7	137.5
2月	電子回路実装基板	573,086	11,228	105.8	102.1	1,090,394	22,318	104.1	104.7
	プリント配線実装基板	530,158	8,580	99.7	96.1	1,010,317	17,091	98.3	98.4
	モジュール実装基板	42,928	2,648	432.4	128.3	80,077	5,227	414.1	132.7
3月	電子回路実装基板	588,503	12,573	113.3	114.4	1,678,897	34,891	107.2	108.0
	プリント配線実装基板	543,485	9,661	106.7	105.2	1,553,802	26,752	101.0	100.7
	モジュール実装基板	45,018	2,912	465.1	161.7	125,095	8,139	431.1	141.8
4月	電子回路実装基板	552,809	11,097	108.9	106.4	2,231,706	45,988	107.6	107.6
	プリント配線実装基板	515,333	8,574	103.7	99.5	2,069,135	35,326	101.7	100.4
	モジュール実装基板	37,476	2,523	338.0	139.0	162,571	10,662	405.4	141.1
5月	電子回路実装基板	558,340	10,791	120.3	105.6	2,790,046	56,779	109.9	107.2
	プリント配線実装基板	517,768	8,318	114.3	99.0	2,586,903	43,644	104.0	100.2
	モジュール実装基板	40,572	2,473	371.0	135.8	203,143	13,135	398.0	140.1
6月	電子回路実装基板	553,389	11,135	109.8	91.5	3,343,435	67,914	109.9	104.3
	プリント配線実装基板	508,684	8,486	102.9	84.5	3,095,587	52,130	103.8	97.2
	モジュール実装基板	44,705	2,649	458.1	124.7	247,848	15,784	407.6	137.2
7月	電子回路実装基板	555,741	10,923	109.6	95.5	3,899,176	78,837	110.1	103.4
	プリント配線実装基板	511,551	8,203	102.9	86.7	3,607,138	60,333	103.9	96.1
	モジュール実装基板	44,190	2,720	448.5	137.5	292,038	18,504	421.4	137.0
8月	電子回路実装基板	498,490	10,314	111.3	98.0	4,397,666	89,151	110.3	102.7
	プリント配線実装基板	458,524	7,612	104.6	88.1	4,065,662	67,945	104.0	95.2
	モジュール実装基板	39,966	2,702	416.3	143.3	332,004	21,206	420.8	137.8
9月	電子回路実装基板	508,542	10,457	101.0	92.4	4,906,208	99,608	109.2	101.5
	プリント配線実装基板	463,771	7,560	93.9	81.3	4,529,433	75,505	102.9	93.6
	モジュール実装基板	44,771	2,897	470.0	143.6	376,775	24,103	426.1	138.5
10月	電子回路実装基板	588,965	13,012	104.7	110.0	5,495,173	112,620	108.7	102.4
	プリント配線実装基板	539,037	9,557	97.6	99.4	5,068,470	85,062	102.3	94.2
	モジュール実装基板	49,928	3,455	511.7	155.8	426,703	27,558	434.6	140.4
11月	電子回路実装基板	584,367	12,736	109.0	112.4	6,079,540	125,356	108.7	103.4
	プリント配線実装基板	533,426	9,508	101.3	103.5	5,601,896	94,570	102.2	95.1
	モジュール実装基板	50,941	3,228	517.2	150.9	477,644	30,786	442.1	141.5

(出所：経済産業省「機械統計月報」)

(2019/1/18 発表 / 2019/1/18 JPCA作成)